

关键指标

- 频率范围：1GHz~12GHz
- 增益：18dB
- 噪声系数：1.6dB
- 输出 P_{1dB}：15dBm
- 封装尺寸：3mmx3mmx1.2mm

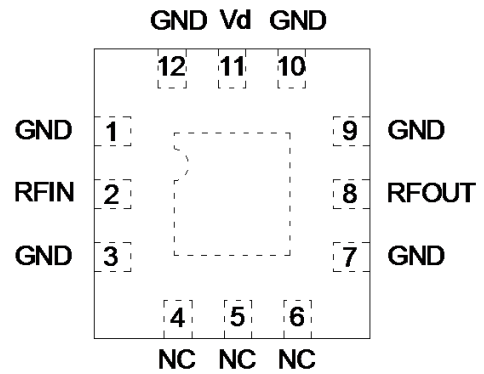
典型应用

- 卫星通信
- 军事及航天
- 测试测量仪器
- 雷达

产品简介

HX130620F3 是无引线 3x3mm 表面贴装封装的 GaAs MMIC 低噪声放大器，工作于 1GHz ~ 12GHz,采用 GaAs工艺制成。该放大器的增益为18dB，输出 P_{1dB}为15dBm，在60mA的电流下噪声系数为1.6dB。

功能框图



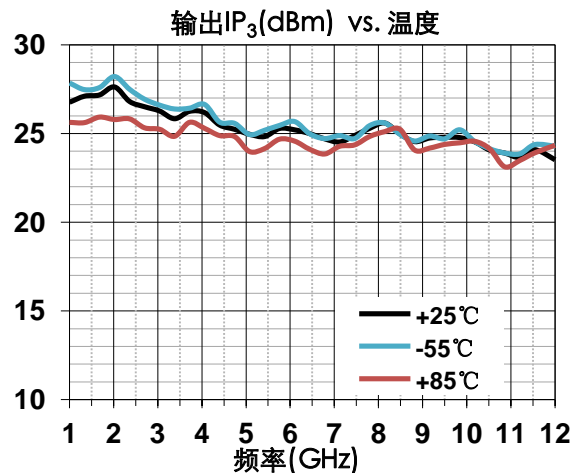
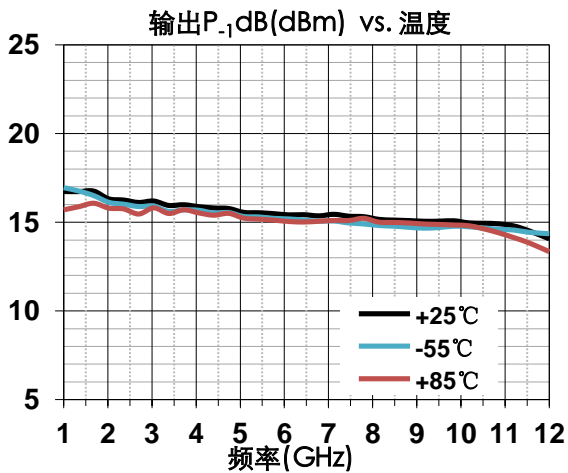
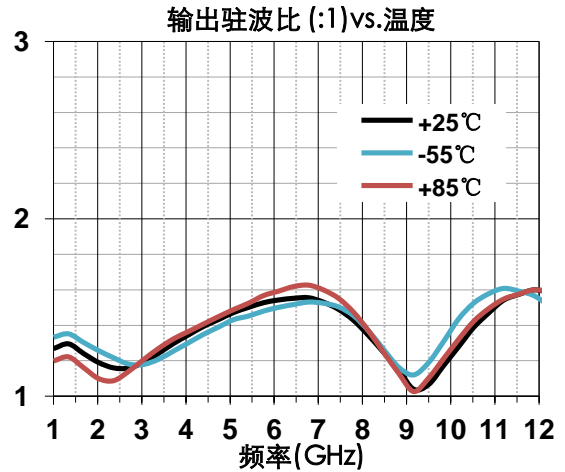
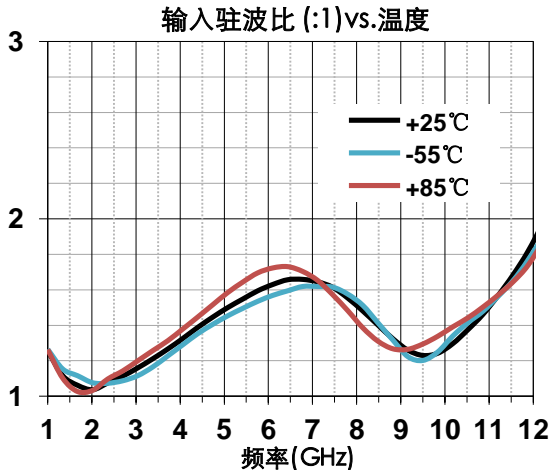
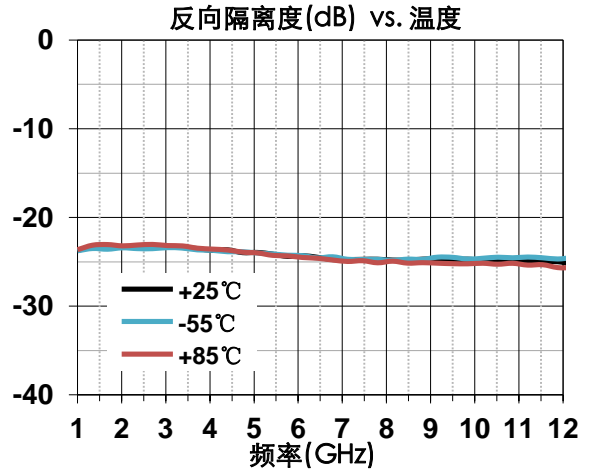
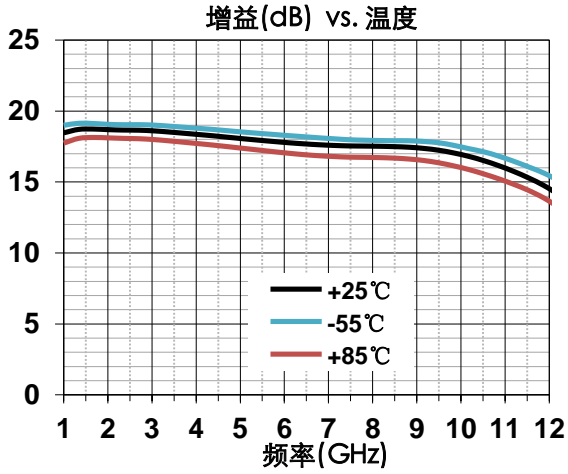
电性能 (T_A=25°C, V_D= +5V, I_D=60mA, Z₀=50Ω)

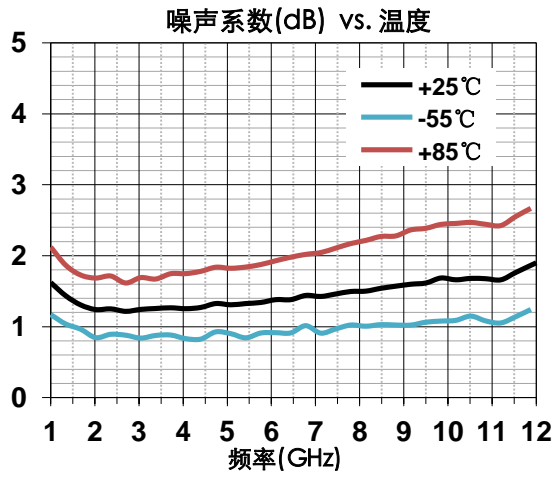
指标	最小值	典型值	最大值	单位
频率	1~12			GHz
增益	14	18	20	dB
增益平坦度	—	±3	—	dB
反向隔离度	-20	-25	—	dB
输入驻波比	—	1.4	2.0	:1
输出驻波比	—	1.4	1.8	:1
噪声系数	—	1.6	2.4	dB
输出 IP ₃	22	25	—	dBm
输出 P _{1dB}	13	15	—	dBm
工作电流	—	60	—	mA

绝对最大额定值

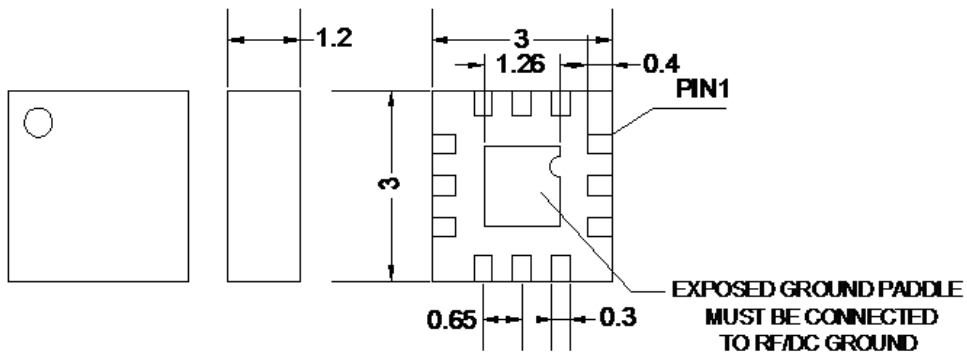
最大输入功率	+10dBm	工作温度	-40°C~+85°C
沟道温度	+150°C	贮存温度	-65°C~+150°C
供电电压	5.5VDC	供电电流	170mA

典型测试曲线

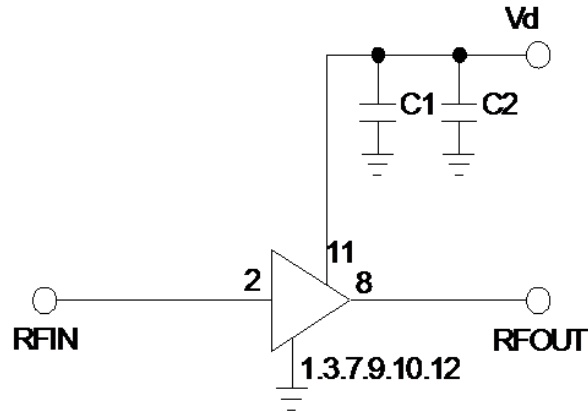




外形尺寸图(mm)



应用电路配置图



元件清单

编号	数值	型号	制造商	封装
C1	100pF	GRM188R61H101KA01	村田	—
C2	10nF	GRM1857U1A103JA44	村田	—

注意事项:

- 1、产品防潮等级为 2a 级，存放环境小于或等于 30° C/60% RH，四周车间寿命；
- 2、撤除真空包装，上回流焊前需在 125+/-5° 环境中烘焙 6 小时，方可焊接。